

シリコンウェハーの代用品としての CNT 皮膜における素材

IC チップと CPU、メモリーにおける基盤としてのプラスチック、フィルムへの CNT 皮膜形成における絶縁体基盤の提供を提案したい。

CNT 特性における絶縁体と半導体は、レーザー加工における IC チップへの可能性や、基盤としての絶縁体として、IC 回路の書き込みなど、その実用化を模索できると考える。

CNT 皮膜は、表面処理における製品化を実現でき、技術特許における可能性を事業化できると考える。